**CON RICHIESTA DI IMMEDIATA**

**PUBBLICAZIONE REFERENTE**

Matt Burns

 matthew.burns@samtec.com

 +1 812-944-6733

**[LOGO SAMTEC] Settembre 2017**

**Samtec** **espande il sistema di connettori per backplane ad alta velocità** **ExaMAX® con nuove opzioni DMO (Direct Mate Orthogonal)**

L’architettura a header ortogonale offre prestazioni migliori riguardo all’integrità del segnale ed efficienza termica superiore

**New Albany, Indiana:** Samtec, un produttore globale a proprietà privata da 662 milioni di dollari che offre un’ampia gamma di soluzioni per dispositivi d’interconnessione elettronici, annuncia l’espansione del sistema di connettori per backplane ad alta velocità ExaMAX® tramite nuove opzioni DMO. I progettisti di sistema ora possono sfruttare i vantaggi intrinseci offerti dalle architetture a header ortogonali e accoppiamento diretto rispetto ai sistemi per backplane tradizionali.

Le nuove soluzioni DMO ExaMAX® di Samtec assicurano ai progettisti di sistemi flessibilità grazie alla rimozione del pannello intermedio, che consente l’accoppiamento diretto tra le fabric card e le schede di linea. Questa architettura di sistema in rapida crescita garantisce una flusso dell’aria a maggiore portata e quindi migliora l’efficienza termica nell’intero châssis. Le soluzioni DMO migliorano l’integrità del segnale grazie alle lunghezze più brevi delle piste e a un numero inferiore di transizioni fra i connettori, al contempo ottimizzando il numero di componenti e il costo del sistema.

Il sistema DMO ExaMAX® di Samtec consiste della nuova serie di connettori [EBDM-RA](https://www.samtec.com/products/ebdm-ra) che si accoppia direttamente con la serie [EBTF-RA](https://www.samtec.com/products/ebtf-ra) preesistente. Attualmente sono disponibili soluzioni a 6 coppie x 10 colonne e 6 coppie x 12 colonne, oltre a opzioni di fissaggio a viti e spine di guida; inoltre sono in fase di sviluppo opzioni a 6 coppie x 6 colonne e 6 coppie x 8 colonne.

“I progettisti di sistemi di prossima generazione stanno adottando rapidamente architetture DMO”, spiega Jonathan Sprigler, Backplane Product Manager presso Samtec, Inc. “I produttori leader nel settore delle apparecchiature per data center – sistemi di archiviazione, server, reti e altre applicazioni – stanno sfruttando i vantaggi di tali architetture tramite la nuova serie EBDM-RA di Samtec.”

La serie Samtec [EBDM-RA](https://www.samtec.com/products/ebdm-ra) è solo una delle soluzioni disponibili scegliendo il sistema di connettori per backplane ad alta velocità ExaMAX®. I prodotti della linea ExaMAX® sono ottimizzati per velocità sino a 56 Gbit/s (modulazione PAM-4). La conformità ai valori dell’attenuazione di ritorno è ottenuta sia nei sistemi a 85 Ω che in quelli a 100 Ω poiché entrambi sono progettati per soddisfare le specifiche corrispondenti a 92 Ω e controllare le riflessioni in tutti i punti di transizione fisica nel connettore.

La linea ExaMAX® offre anche la forza di accoppiamento più bassa nel settore – il valore di forza normale è eccellente – e risponde alle specifiche Telcordia GR-1217 CORE. Grazie ai due affidabili punti di contatto in qualsiasi momento, anche quando l’accoppiamento è angolato, si riducono al minimo gli stub residui migliorando così l’integrità del segnale. Una lunghezza di strisciamento di 2,4 mm del contatto aumenta l’affidabilità, mentre l’interfaccia ermafrodita assicura un accoppiamento senza stub e un allineamento affidabile.

Questo sistema per backplane presenta wafer di segnale individuali con coppie differenziali in una configurazione sfalsata e disposte in colonne con disallineamento nullo. Ciascun wafer include una struttura di massa a rilievo monolitica, che aumenta l’isolamento per ridurre notevolmente la diafonia.

Per maggiori informazioni guardare il webinar “[High-Speed Backplane Connectors Drive 56 Gbps and Beyond”](http://www.eejournal.com/chalk_talks/high-speed-backplane-connectors-drive-56-gbps-and-beyond/), visitare la pagina web [ExaMAX® High-Speed Backplane Connector System](https://www.samtec.com/connectors/backplane/high-speed-backplane-systems/examax) o scaricare il manuale [High-Speed Board-to-Board Application Design Guide](http://suddendocs.samtec.com/literature/samtec-high-speed-b2b-design-guide.pdf). È disponibile assistenza tecnica tempestiva da parte degli esperti Samtec di applicazioni per backplane inviando un’e-mail a HSBP@samtec.com.

**Informazioni su Samtec, Inc.**

Fondata nel 1976, Samtec è un’azienda produttrice globale a proprietà privata da 662 milioni di dollari che offre un’ampia gamma di soluzioni per dispositivi d’interconnessione elettronici: tra circuiti integrati e schede e per package di circuiti integrati, tra schede ad alta velocità, cavi ad alta velocità, pannelli intermedi e sistemi ottici su pannello, impilamento flessibile oltre a cavi e componenti affidabili e di dimensioni ridottissime. I centri tecnologici Samtec sviluppano e perfezionano tecnologie, strategie e prodotti per ottimizzare sia le prestazioni che il costo di sistemi dalla semplice piastrina a un’interfaccia situata a 100 metri di distanza nonché tutti i punti di interconnessione intermedi. La presenza globale di Samtec – 33 sedi in 18 Paesi – le permette di offrire un servizio clienti ineguagliato. Per ulteriori informazioni visitare il sito <http://www.samtec.com>.

ExaMAX® è un marchio registrato di Amphenol Corporation.

**Samtec, Inc.**

**P.O. Box 1147**

**New Albany, IN 47151-1147**

**USA**

**Telefono: 1-800-SAMTEC-9 (800-726-8329)**

[www.samtec.com](http://www.samtec.com)